創新醫材技術發表暨研討會

全球經濟自 2010 年進入低度成長時代，各國政府因應產業轉型及新經濟局面之需求，推動各類政策工具啟動成長引擎，尤以科技研發與創新投入更是不遺餘力；在人口結構高齡化及民眾對醫療照護品質提升的期待下，不論需求市場或人均醫療器材消費支出均逐年提高，高階新穎的醫療器材需求，將使得醫療器材產業的成長幅度持續增加。

我國政府為加速國內醫療器材產業轉型與升級，近年來透過各項輔導與推動計畫，朝向高附加價值之高階醫療器材發展。經濟部技術處為促進提升國內醫療器材產業發展，委託金屬工業研究發展中心執行「數位口腔復形與快速取像系統暨醫材創新服務平台計畫」，研發差異化關鍵技術及創新醫療器材，配合產業服務推動，優化我國高階醫材產業結構。為使各界瞭解計畫開發成果以及擴大國內醫療器材廠商新技術及產品來源，特舉辦「創新醫材技術發表暨研討會」，並邀請國內知名臨床、產業及法規專家進行專題演講研討，歡迎各界先進共同交流。

指導單位：DOIT 經濟部技術處

主辦單位：財團法人金屬工業研究發展中心

時　　間：105 年 12 月 05 日(一)

地　　點：台大醫院國際會議中心　402 AB 會議室

(100 台北市中正區徐州路 2 號)

費　　用：免費(名額有限，額滿為止)

參與對象：1.醫療暨生技器材業者

2.有意跨足醫療產業廠商

3.對醫療器材發展有興趣之各界人士

活動議程：

時間	議程/主題	主講人
12:30~13:00	迎　賓　報　到	
13:00~13:10	長官與貴賓致詞	經濟部技術處 長官 金屬中心 林志隆 副執行長
13:10~14:10	技術及產品發表(一)：臨床創新醫材原型發表 1. 微創手術用肝臟回縮輔助器械 2. 智慧顯示型敷料 3. 術中靜動脈光學顯影儀開發 4. 口腔保護裝置 5. 微創手術之髖關節斷裂固定植入物 6. 低應力下顎重建骨板	金屬工業研究發展中心 陳銘輝 工程師 金屬工業研究發展中心 謝蘋怡 工程師 金屬工業研究發展中心 許哲彰 工程師 金屬工業研究發展中心 彭耀德 工程師 金屬工業研究發展中心 蔡東霖 工程師 金屬工業研究發展中心 王躍鈞 工程師
14:10~14:30	專題演講(臨床)：3D 列印於臨床醫材發展及應用趨勢	台大醫院骨科部 張志豪 主治醫師
14:30~15:00	技術及產品發表(二)： 精準口腔補綴系統 表面處理技術	金屬中心 潘柏瑋 副組長 金屬中心 翁麗雯 工程師
15:00~15:10	休　息　&　實　體　成　果　展　示	
15:10~15:40	專題演講(產業)：3D 列印客製化醫療發展：一、二、三類醫材的最新應用	德芮達科技股份有限公司 邱雲堯 總經理
15:40~16:00	技術及產品發表(三)：攝像式口內掃描系統與診所端雷射雕銑技術	金屬中心 胡博期 工程師
16:00~16:30	專題演講(法規)：3D 列印醫材(含客製化醫材)法規指引	DNV•GL 洪哲章資深主任稽核員
16:30~	賦　歸	

*主辦單位得保留變更研討會議程及講師之權利(若遇不可預測之因素，致使主辦單位無法於會前及時通之所有學員，敬請見諒)。

報名辦法：

1. Email 報名：填妥報名表格寄至 qiong@mail.mirdc.org.tw。
2. 網路報名：
3. 傳真報名：填具報名表後傳真至 07-6955627 顏小姐收
4. 報名時間：即日起至 105 年 12 月 2 日止
5. 洽詢電話：(07)6955298 轉 265 顏小姐

報　名　表

創新醫材技術發表暨研討會				報名日期	年　月　日
姓名	職稱	＊E-MAIL		膳食	
				□葷　□素	
				□葷　□素	
				□葷　□素	
				□葷　□素	
				□葷　□素	
公司名稱：				＊電　話	
公司地址：				＊傳　真	
聯絡人		職　稱		統一編號	
電話/手機		＊E-mail			
請問您是透過何處得知活動訊息 (請勾選) □傳真　□網站　□電子郵件 □郵寄　□協會　□其他				有＊記號之欄位務必填寫，以利報名確認及日後的活動訊息通知。 ＊本表如不敷使用，請自行影印，謝謝！	

會場位置圖

台大醫院國際會議中心

地址：100 台北市中正區徐州路 2 號

會議中心交通位置：http://www.thcc.net.tw/about06.html